

姓 名	郭福	性 别	男	职称	教授
最后学历	博士研究生	最后学位	博士	获学位单位	美国密歇根州立大学
任硕导时间	2003 年 9 月	任博导时间	2004 年 5 月	机电学院招生联系人及邮箱	杜逸辉, duyihui@bistu.edu.cn
所属学科及学科方向	机械工程			研究方向 1	先进电子封装互连材料设计
	机械制造及其自动化			研究方向 2	电子封装互连焊点服役可靠性评价
工作简历	2001 年 12 月于美国密歇根州立大学电子与计算机工程系电子材料实验室进行博士后研究工作； 2003 年 9 月起在北京工业大学材料学院任教，2004 年 1 月起任教授，2004 年 5 月任博士生导师，2004 年 12 月任材料学院党委副书记； 2010 年起历任北京工业大学教务处处长、招生办公室主任、樊恭煦荣誉学院院长、材料学院院长、材料与制造学部主任； 2019 年 11 月至 2021 年 12 月，任北京工业大学副校长； 2021 年 12 月至 2023 年 07 月，任北京联合大学党委副书记、校长； 2023 年 7 月至今，任北京信息科技大学党委副书记、校长。				
科研项目情况	2022 年 10 月至 2024 年 12 月，高低温循环载荷下 SiO ₂ @Ni 增强 Sn 基复合钎料热疲劳服役可靠性研究，80 万，北京市教委重点项目； 2023 年 3 月至 2026 年 10 月，退役机电电控模块智能检测及再利用与退役电池智能拆解技术，534.6 万，国家重点研发计划项目； 2023 年 2 月至 2024 年 12 月，航空发动机用高品质高温合金粉末的研制及产业化，157 万，北京市科技计划项目； 2022 年 8 月至 2024 年 12 月，高可靠互连材料可靠性研究，17 万，企事业单位委托项目； 2024 年 12 月至 2027 年 12 月，金属封隔层井下原位生成机理与控制方法研究，116.9 万，国家自然科学基金重点项目。				
主要科研成果	1. Thermoelectric performance of hydrothermally synthesized micro/nano Cu _{2-x} S, Chemical Engineering Journal, Volume 449, 2022, 137748, 通讯作者； 2. Enhanced thermoelectric properties of Ag doped Cu ₂ S by using hydrothermal method, Journal of Alloys and Compounds, Volume 919, 2022, 165830, 通讯作者； 3. Stable SnAgCu solder joints reinforced by nickel-coated carbon fiber for electronic packaging, Engineering Fracture Mechanics, Volume 307, 2024, 110265, 通讯作者； 4. Atomic insight into the interfacial reactions in Ni-Sn-Cu systems: A TEM and molecular dynamic study, Applied Surface Science, Volume 705, 2025, 163507, 通讯作者； 5. 一种基于核壳结构强化相增强的Sn基无铅复合钎料, 中国发明专利授权, ZL202211069185.2, 第一作者.				
获奖情况	2001 年获得美国密歇根州立大学工程院颁发的最佳学术成果奖。 2004 年入选北京市科技新星计划及教育部新世纪优秀人才支持计划。 2006 年获得霍英东基金和北京市青年“五四奖章”。 2008 年获得北京市优秀党务工作者；北京工业大学优秀共产党员；《材料科学基础》被评为国家级双语教学示范课、北京市精品课程，北京市 2008 年精品教材；北京工业大学 2008 年教学优秀奖； 2009 年，北京工业大学优秀辅导员；北京工业大学优秀共产党员； 2012 年获得北京市教育教学成果奖一等奖。 2013 年获得第三届全国教育改革创新先锋教师奖。 2014 年获得北京市师德标兵。 2016 年被授予“北京市优秀共产党员”荣誉称号； 2017 年获得首都劳动奖章、北京市优秀教育工作者。 2018 年获得北京市教育教学成果奖一等奖。 2019 年获得全国优秀教育工作者荣誉称号。				
开授课程	材料与社会，材料科学基础（双语）				
参加学术团体	北京先进碳材料产业促进会会长				